



Спид Спреад Электронные Материалы Компания
с ограниченной ответственностью

Введение в инженерную продукцию

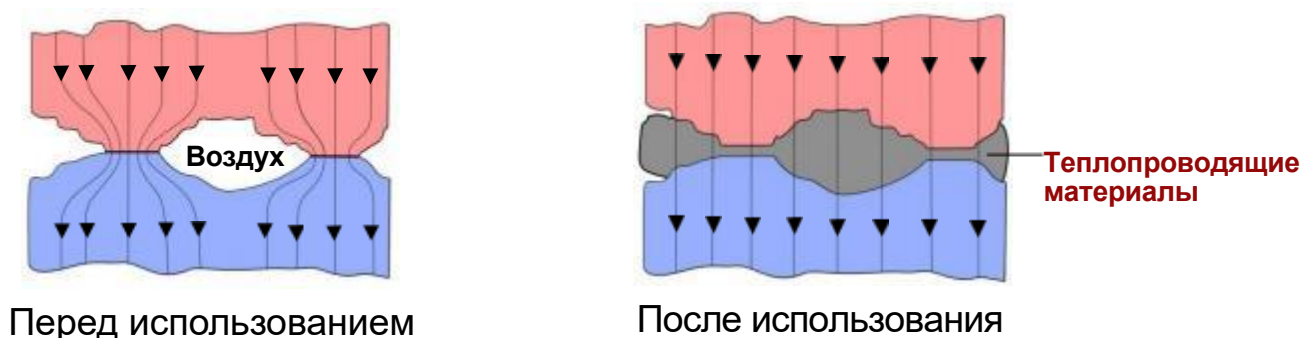


Краткое описание TIM

Краткое описание материалов термического интерфейса

Теория теплопроводности

Тепло нагревательного элемента может эффективно и быстро отводиться, избегая слишком высокой температуры нагревательного компонента, которая может привести к снижению эффективности работы или повреждению.



Теплопроводность K

Отношение тепла ко времени при разнице температур 1 (К или °C) через единицу площади и толщину. Теплопроводность, это физическая величина, описывающая способность материала к теплопередаче. Это неотъемлемое свойство однородных материалов, не имеющее ничего общего с размером и формой материала.

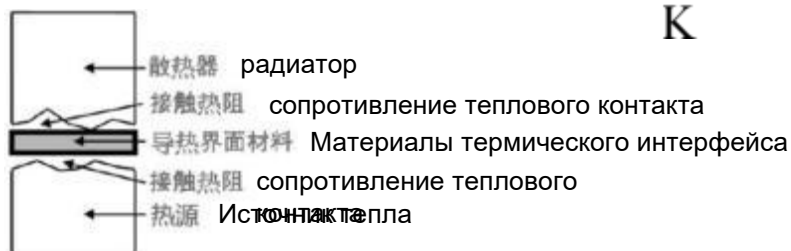
$$K = \frac{Q}{A \cdot dt}$$

Тепловое сопротивление R

Величина сопротивления теплопередаче через интерфейс или материал, свойство, связанное с толщиной и площадью.

R контакт: сопротивление теплового контакта

$$R = \frac{X_{\text{(толщина)}}}{K} \quad R_{\text{контакт}}$$



Все компоненты, которым необходимо рассеивать тепло, могут использовать теплопроводящие материалы.



**Новые энергетические
станции и зарядные
станции**



Сервер



**Базовая станция
связи**



Ноутбук



Экран ТВ-дисплея



Мобильный терминал



Мобильный терминал



Солнечная панель



Светодиод

Список продуктов

Краткое описание материалов термоинтерфейса

SC-TP

Теплоизоляционная прокладка

SC-TCF

Теплопроводящая прокладка из углеродного волокна

SC-TFC

Теплопроводящий материал с фазовым переходом

SC-TS

Теплоизоляционная грязь

SC-TG

Термопаста

SC-TIS

Теплоизоляционная смазка

SC-TA

Теплопроводящий волнопоглощающий материал

SC-NTP

Термопрокладка PMMA без силикона Масло

SC-CH

Тепловой керамический радиатор

SC-STG/DTG

Теплопроводящий гель

Точная высечка - резка

Графит, токопроводящая пена, теплоизоляционный аэрогель, двусторонний скотч и т. д.

SC-TPSC-TP

Теплоизоляционная прокладка

Введение

Теплопроводящий силикон обладает высокой мягкостью, хорошей сжимаемостью, сильной самоадгезией и превосходными заполняющими свойствами.

Свойство

Теплопроводность 1,5-15,0 Вт/м·К, может быть распределен по неровным поверхностям, не деформируется, имеет сильную самоадгезию, низкое тепловое сопротивление, огнестойкий и имеет хорошую изоляцию.

Приложение

- Автомобильное литиевое устройство охлаждения аккумулятора
- Светодиодное осветительное оборудование
- Оборудование для преобразования мощности
- Оборудование для преобразования источника питания
- Блок управления автомобильным двигателем
- Применение для гашения вибрации



Название продукта	SC-TP150	SC-TP200	SC-TP300	SC-TP400	SC-TP500	SC-TP600	SC-TP800	SC-TP1000	SC-TP1200	SC-TP1500
Цвет	Светло голубой	От белого	Светло зеленый	Фиолетовый	Желтый	Розовый	Светло-серый	Светло-серый	Светло-серый	Светло-серый
Теплопроводность W/m·K	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	15.0
Толщина mm	0.15 ~ 10	0.2 ~ 10	0.25 ~ 10	0.3 ~ 10	0.5 ~ 10	0.5 ~ 10	0.5 ~ 10	0.5 ~ 10	0.5 ~ 10	0.5 ~ 10
Твёрдость	40	40	45	45	50	50	55	55	55	55
Плотность g/cm³	1.75	2.5	2.98	3.1	3.2	3.26	3.36	3.3	3.3	3.3
Напряжение пробоя KV (>1mm)	>6	>6	>5	>5	>5	>5	>6	>5	>5	>5
Диэлектрическая постоянная @1Mhz	5.3	7.0	7.3	7.5	7.4	7.9	7.2	7.0	7.0	7.0
Объемное сопротивление Ω·cm	10 ¹²	10 ¹³	10 ¹³	10 ¹³	10 ¹⁰	10 ¹²	10 ¹²	10 ¹²	10 ¹²	10 ¹²
Диапазон температур °C	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150
Рейтинг пламени	94V-0	94V-0	94V-0	94V-0	94V-0	94V-0	94V-0	94V-0	94V-0	94V-0

Вышеуказанное содержание и техническая информация основаны на экспериментальных результатах нашей компании, но они не используются в качестве юридического толкования или гарантии. Перед использованием пользователи должны оценить цель применения и область применения продукта.

SC-TCF

Теплопроводящая прокладка из углеродного волокна

Введение

SC-TCF — это новая легкая, высокопрочная направленная термопрокладка со сверхвысокой теплопроводностью и сверхнизким термическим сопротивлением. Благодаря использованию передовой технологии компоновки теплопроводящий наполнитель равномерно и вертикально распределяется в матрице молекул с высокой теплопроводностью, что может значительно повысить эффективность теплопередачи. В то же время низкий коэффициент заполнения позволяет материалу иметь хорошие механические свойства и превосходную термическую стабильность, и широко используется в электронной области с высокими требованиями к рассеиванию тепла. Этот высокотеплопроводящий наполнитель сам по себе является волокнистым и может быть спроектирован с тепловой ориентацией, что является самым большим отличием и преимуществом по сравнению с предыдущими теплопроводящими материалами.

Свойство

- Теплопроводность 20~35 Вт/м·K
- Сверхнизкое тепловое сопротивление, низкий коэффициент заполнения, легкий вес
- Нулевая утечка масла, отличная надежность
- Безопасный и экологически чистый, совместим с RoHS
- Устойчив к коррозии, антиокислительный

Приложение

- Спутники, радары
- Большие серверы
- Центры обработки данных
- Преобразователи сигналов
- Устройства массового хранения данных
- Устройства высокой мощности
- Электронное коммуникационное оборудование



Название продукта	SC-TCF2000	SC-TCF2500	SC-TCF3000	SC-TCF3500
Цвет	Черный	Черный	Черный	Черный
Стандартные размер (mm)	100*100	100*100	100*100	100*100
Толщина (mm)	0.5 to 5.0	0.5 to 5.0	0.5 to 5.0	0.5 to 5.0
Теплопроводность (W/m-k)	20.00	25.00	30.00	35.00
Твёрдость (Shore00)	55±5	55±5	55±5	55±5
Плотность g/cm³	2.5±0.2	2.5±0.2	2.5±0.2	2.5±0.2
Напряжение пробоя KV (>1mm)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Рейтинг пламени	V-0	V-0	V-0	V-0
Диапазон температур °C	-40 to 150	-40 to 150	-40 to 150	-40 to 150
Тепловое сопротивление @50psi@1mm(°C-cm2/W)	≤0.11	≤0.11	≤0.11	≤0.11

Вышеуказанное содержание и техническая информация основаны на экспериментальных результатах нашей компании, но они не используются в качестве юридического толкования или гарантии. Перед использованием пользователи должны оценить цель применения и область применения продукта.

SC-TFC

Теплопроводящий материал с фазовым переходом

Введение

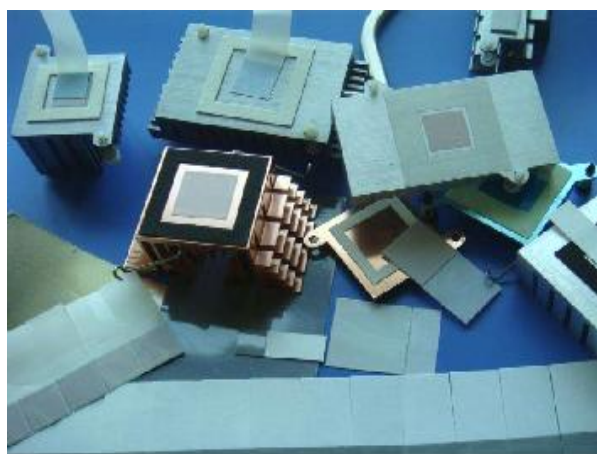
Теплопроводящие материалы с фазовым переходом часто используются для заполнения зазоров между высокоэффективными процессорами и модулями рассеивания тепла, чтобы обеспечить чрезвычайно низкое тепловое сопротивление. Этот материал претерпевает фазовый переход при 50-52°C, имеет определенную текучесть, но не переливается, может полностью заполнять зазоры, тщательно смачивать контактную поверхность и улучшать теплопередачу между нагревательной частью и частью рассеивания тепла. Теплопроводящие прокладки обладают присущими им адгезионными свойствами, не требуют адгезионного слоя и покрывают микроскопическую неровную поверхность, так что сопрягаемые части полностью соприкасаются и улучшают эффективность теплопередачи.

Свойство

- Очень низкое термосопротивление
- Высокая адгезионная поверхность для удобства использования
- Соответствует RoHS

Приложение

- Настольные компьютеры, ноутбуки и серверы
- Микропроцессоры
- Чипы и чипсеты
- Модули охлаждения NB
- Видеокарты
- Модули хранения данных



Цвет	Розовый	Желтый	Серый	Серый	Серый	Серый
Теплопроводность W/m·K	1.0±0.3	2.0±0.3	3.0±0.3	5.0±0.3	6.0±0.3	8.0±0.3
Толщина (mm)	0.1 ~ 1.0	0.1 ~ 1.0	0.1 ~ 1.0	0.1 ~ 0.5	0.1 ~ 0.5	0.1 ~ 0.5
Изменение температуры °C	55 ~ 60	55 ~ 60	45 ~ 55	45 ~ 55	45 ~ 55	45
Плотность g/cm³	2.3	2.7	3.15	2.8	2.8	2.8
Тепловое сопротивление 50psi(°C-cm²/W)	<0.22	<0.18	<0.14	< 0.07	< 0.06	< 0.05
Диэлектрический коэффициент MHz	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
Объемное сопротивление Ω·cm	4.0x 10 ¹³	4.0x 10 ¹³	4.0x 10 ¹³	2.0x 10 ¹³	2.0x 10 ¹³	2.0x 10 ¹³
Диапазон температур °C	-20~120	-20~120	-20~120	-20~120	-20~120	-20~150

Вышеуказанное содержание и техническая информация основаны на экспериментальных результатах нашей компании, но они не используются в качестве юридического толкования или гарантии. Перед использованием пользователи должны оценить цель применения и область применения продукта.

SC-TS

Теплоизоляционная грязь

Введение

Как среда для передачи тепла, теплопроводящая грязь FG обладает отличной теплопроводностью, хорошей смазывающей способностью и электроизоляцией, а также хорошей устойчивостью к высоким и низким температурам. Она имеет низкую вязкость и хорошие строительные характеристики. Этот продукт основан на полисилоксане и дополнен наполнителями с высокой теплопроводностью. Он нетоксичен, не имеет запаха и не вызывает коррозии. Он соответствует директивам R O H S и связанным с ними требованиям по защите окружающей среды, а также имеет стабильные химические и физические свойства.

Свойство

- Сильная пластичность, простота использования
- Тщательно смочите контактную поверхность для улучшения эффекта рассеивания тепла
- Безопасно и экологично, Соответствует RoHS

Приложение

- Компьютерные процессоры ЦП
- Чипы и чипсеты Блоки питания и ИБП
- Видеокарты ЖК-дисплеи и плазменные панели
Плоские дисплеи
- Устройства хранения данных большой емкости
- Вентиляторы охлаждения компьютеров



Конфигурация и хранение продукта

1 кг/банка, 2 кг/банка, 10 кг/бочка; шприц 30 куб. см.

Хранить в сухом и прохладном месте. Срок годности 12 месяцев.

Цвет	От белого	От белого	От белого
Теплопроводность W/m·K	1.0±0.3	2.0±0.3	3.0±0.3
Плотность g/cm³	1.75	2.3	2.98
Напряжение пробоя KV (>1mm)	4	4	4
Объемное сопротивление Ω·cm	4.0x 10 ¹³	4.0x 10 ¹³	4.0x 10 ¹³
Диапазон температур	-40~150	-40~150	-40~150
Рейтинг пламени	94V-0	94V-0	94V-0
Упаковка	Наполнение вещей	Наполнение вещей	Наполнение вещей

Вышеуказанное содержание и техническая информация основаны на экспериментальных результатах нашей компании, но они не используются в качестве юридического толкования или гарантии. Перед использованием пользователи должны оценить цель применения и область применения продукта.

SC-TG

Термопаста

Введение

В качестве среды для передачи тепла термопаста TG обладает отличной теплопроводностью, хорошей смазывающей способностью и электроизоляцией, а также хорошей устойчивостью к высоким и низким температурам; имеет низкую вязкость и хорошие конструкционные характеристики. Этот продукт основан на полисилоксане и дополнен наполнителями с высокой теплопроводностью. Он нетоксичен, не имеет запаха и не вызывает коррозии, соответствует директиве R O H S и связанным с ней требованиям по защите окружающей среды, имеет стабильные химические и физические свойства.

Свойство

- Теплопроводность 1,0~6,0 Вт/м·К
- Чрезвычайно низкое тепловое сопротивление, лучшая теплопередача
- Тщательно смочите контактную поверхность для улучшения эффекта рассеивания тепла
- Безопасный и экологически чистый, соответствует RoHS

Приложение

- Компьютерные процессоры ЦП
- Чипы и чипсеты
- Блоки питания и ИБП
- Видеокарты
- ЖК-дисплеи и плазменные панели
- Устройства хранения данных большой емкости
- Вентиляторы охлаждения компьютера

Конфигурация и хранение продукта

1 кг/банка, 2 кг/банка, 10 кг/бочка; шприц 30 куб. см.

Хранить в сухом прохладном месте. Срок годности 12 месяцев.



Цвет	Белый	От белого	Серый	Серый	Серый	Серый
Теплопроводность	1.0±0.3	2.0±0.3	3.0±0.3	4.0±0.3	5.0±0.3	6.0±0.3
Испарение	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Плотность g/cm ³	2.2	2.5	2.78	3.15	3.15	3.15
Тепловое сопротивление Ω·cm	0.256	0.212	0.221	0.256	0.08	0.08
Напряжение пробоя KV (>1mm)	5	5	5	5	5	5
Диапазон температур °C	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150

Вышеуказанное содержание и техническая информация основаны на экспериментальных результатах нашей компании, но они не используются в качестве юридического толкования или гарантии. Перед использованием пользователи должны оценить цель применения и область применения продукта.

SC-TIS

Теплоизоляционная смазка

Введение

TIS — это двухкомпонентный, высокотеплопроводный, отверждаемый при комнатной температуре, с длительным рабочим временем, огнестойкий силиконовый заливочный компаунд. Он особенно подходит для заливки конденсаторов и небольших электронных устройств. Его гибкость и эластичность позволяют ему обеспечивать буфер для покрытого материала. Более низкая вязкость позволяет теплопроводящему заливочному компаунду более полно покрывать поверхность в течение периода, значительно повышая эффективность теплопередачи от нагревательного устройства или всей печатной платы к металлическому корпусу или диффузионной пластине, тем самым повышая эффективность и срок службы электронных компонентов.

Свойство

- Хорошая изоляция
- Низкая вязкость, способствует газовой выделению
- Хорошая стойкость к растворителям и водонепроницаемость
- Отличная стойкость к высоким и низким температурам

Приложение

- Источник питания, разъем, датчик, промышленный контроллер, трансформатор, катушка, усилитель, высоковольтный пакет, реле, силовая распределительная коробка и т. д.
- Сборка радиатора, заливка термодатчика, заливка теплопроводящих изделий
- Теплопроводность между ячейкой аккумулятора и охлаждающей трубкой
- Заливка светодиода и драйвера питания

Название продукта	SC-TIS15AB	SC-TIS20AB	SC-TIS30AB	SC-TIS40AB
Цвет	Белый	Белый	Белый	Белый
Теплопроводность W/m·K	1.2	2.0	3.0	4.0
Толщина mm	0.15 ~ 5	0.2 ~ 5	0.25 ~ 5	0.3 ~ 5
Твёрдость Shore A	40	40	50	50
Плотность g/cm ³	1.75	2.5	2.98	3.1
Напряжение пробоя KV (>1mm)	>6	>6	>5	>5
Диэлектрическая постоянная @1Mhz	5.3	7.0	7.3	7.5
Объемное сопротивление Ω·cm	10 ¹²	10 ¹³	10 ¹³	10 ¹³
Диапазон температур °C	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150
Рейтинг пламени	94V-0	94V-0	94V-0	94V-0

Вышеуказанное содержание и техническая информация основаны на экспериментальных результатах нашей компании, но они не используются в качестве юридического толкования или гарантии. Перед использованием пользователи должны оценить цель применения и область применения продукта.

SC-TA

Теплопроводящий волнопоглощающий материал

Введение

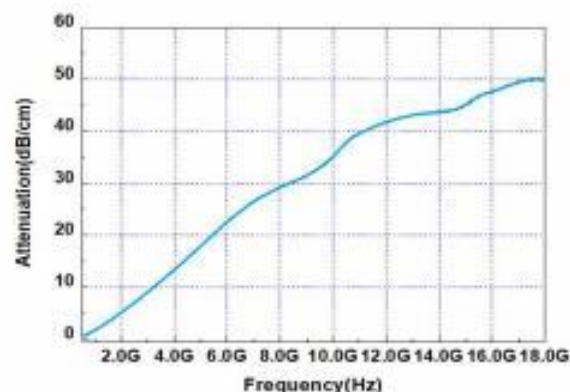
Теплопроводящие поглотительные накладки SC-TAxxx обладают хорошей теплопроводностью, могут поглощать электромагнитные волны, обладают экранирующим эффектом и характеристиками выдерживаемого напряжения изоляции. Низкое тепловое сопротивление интерфейса может быть достигнуто при относительно низком давлении. Воздух может быть эффективно исключен для достижения хорошего эффекта заполнения. Его можно напрямую применять между радиатором и металлической оболочкой для эффективного экспорта тепловой энергии. В то же время он обладает характеристиками электромагнитного экранирования и поглощения электромагнитных помех, обеспечивая хорошее решение для электронных изделий в области теплопроводности и электромагнитного экранирования.

Свойство

- Высокая теплопроводность, низкое тепловое сопротивление
- Хорошие изоляционные и выдерживаемые характеристики напряжения
- Отличная способность к затуханию электромагнитных волн, хорошая совместимость с поверхностью
- Хорошая упругость, хорошая самоадгезия
- Высокая долговременная надежность

Приложение

- Базовые станции 5G
- БПЛА/дрон
- Оптические модули, усилители
- Ноутбуки, роутеры, телевизоры
- Медицинское оборудование, электронные диагностические приборы



характеристика	SC-TA300	единица	метод испытания
Цвет	Dark Grey	-	Visual
Толщина	0.5~3.0	mm	ASTM D374
Твёрдость	50	Shore 00	ASTM D2240
Плотность	3.1	g/cm ³	ASTM D792
Диапазон температур	-45~150	°C	N/A
Коэффициент затухания	30	dB/cm	@8Ghz
	45	dB/cm	@15Ghz
Напряжение пробоя	>6	kv	ASTM D149
Поверхностное сопротивление	10 ¹⁰	Ω	ASTM D2574
Теплопроводность	3.0	W/mk	ASTM C518-98

Вышеуказанное содержание и техническая информация основаны на экспериментальных результатах нашей компании, но они не используются в качестве юридического толкования или гарантии. Перед использованием пользователи должны оценить цель применения и область применения продукта.

SC-NTP

Термопрокладка PMMA без силикона Масло

Введение

Несиликоновые термопрокладки NTP представляют собой акриловые материалы с превосходными свойствами сильной самоадгезии, отсутствия утечки масла и коррозионной стойкости. В отличие от обычных термопрокладок, не содержащие силикон термопрокладки обладают превосходной механической прочностью, ударной вязкостью и износостойкостью. Они подходят для использования в особых условиях, таких как высоковольтные и ударопрочные литиевые батареи. При использовании литиевых батарей не содержащие силикон термопрокладки могут эффективно предотвращать растворение электролитов, поэтому они широко используются в промышленности литиевых батарей.

Свойство

- Никаких масляных пятен, избегайте загрязнения маслом
- Уникальные свойства акриловой кислоты, сильная адгезия, нет необходимости в клее
- Безопасно и экологично, соответствует RoHS

Приложение

- Компьютерные процессоры ЦП
- Чипы и чипсеты
- Блоки питания и ИБП
- Видеокарты
- ЖК-дисплеи и плазменные панели
- Устройства хранения данных большой емкости
- Вентиляторы охлаждения компьютера



Название продукта	SC-NTP150	SC-NTP200	SC-NTP300	SC-NTP400	SC-NTP500	SC-NTP600
Цвет	белый	белый	белый	белый	белый	белый
Теплопроводность W/m·K	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
Толщина mm	0.15 ~ 5	0.2 ~ 5	0.25 ~ 5	0.3 ~ 5	0.5 ~ 5	0.5 ~ 5
Твёрдость Shore00	65	65	65	65	65	65
Плотность g/cm ³	1.75	2.5	2.98	3.1	3.2	3.26
Напряжение пробоя KV (>1mm)	>6	>6	>5	>5	>5	>5
Диэлектрическая постоянная @1Mhz	5.3	7.0	7.3	7.5	7.4	7.9
Объемное сопротивление Ω·cm	10 ¹²	10 ¹³	10 ¹³	10 ¹³	10 ¹⁰	10 ¹²
Диапазон температур °C	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150
Класс огнестойкости	94V-0	94V-0	94V-0	94V-0	94V-0	94V-0

Вышеуказанное содержание и техническая информация основаны на экспериментальных результатах нашей компании, но они не используются в качестве юридического толкования или гарантии. Перед использованием пользователи должны оценить цель применения и область применения продукта.

SC-CH

Тепловой керамический радиатор

Введение

Керамический материал H.SAC обладает характеристиками хорошей изоляции, высокой теплопроводности, высокой скорости инфракрасного излучения и низкого коэффициента расширения. Он может стать новым материалом для рассеивания тепла в светодиодном освещении и сетевых коммуникационных продуктах.

H.SAC может выдерживать большой ток, высокое напряжение, пробой утечки, отсутствие шума и не будет создавать паразитную емкость связи с МОП и другими силовыми трубками, что упрощает процесс фильтрации; требуемое расстояние утечки короче, чем требуется финансовым органом, что дополнительно экономит место на плате и более благоприятно для проектирования инженерами и электрической сертификации; H.SAC имеет многонаправленное рассеивание тепла и подходит для упаковки ИС с многонаправленным рассеиванием тепла; Материал H.SAC имеет небольшой размер, легкий вес, не занимает места и более благоприятен для разумной компоновки дизайна продукта;

H.SAC имеет хорошие характеристики рассеивания тепла и теплопередачи, что может эффективно решить проблему рассеивания тепла электронных продуктов и силовых компонентов и продлить срок службы продуктов.

Свойство

Как зеленый и экологически чистый материал, продукт в основном используется в светодиодном освещении и связанных с ним электронных отраслях. Керамические изделия H.SAC могут эффективно решать проблемы теплопроводности и рассеивания тепла в электронной и оптоэлектронной промышленности, а также обеспечивать техническую поддержку и прорывы для инноваций и разработки электронных продуктов.

Приложение




- Компоненты: ИС, чипсеты, ЦП, МОП, Южный мост
- Светодиод: радиатор общего (коммерческого) освещения
- Телевизор: тонкий ЖК-телевизор/приставка
- Сетевое оборудование: AP, Route, ADSL, Modern, S/W
- Информационные технологии: M/B, NB, Video, Card
- Память: DDR3-DIMM, SO-DIMM, SSD
- Источник питания: силовой модуль, силовой транзистор

Размер

Размер продукта: Различные формы

SC-CH

Тепловой керамический радиатор

Тепловой керамический радиатор			
--------------------------------	---	--	---

Вышеуказанное содержание и техническая информация основаны на экспериментальных результатах нашей компании, но они не используются в качестве юридического толкования или гарантии. Перед использованием пользователи должны оценить цель применения и область применения продукта.

SC-CH

Тепловой керамический радиатор

	Конкретные продукты	Единица	Данные	Тест
Физические свойства	Плотность У.С.	g/cm ³	2.0 ±0.05	GB/T 3810.3-2006
	Пористость	%	30	GB/T 3810.3-2006
Механические свойства	Твёрдость по шкале Мооса	Mohs	5~6	DIN EN101-1992
	Прочность на изгиб	MPa	87.82	GB/T 14389-14390
	Теплопроводность	w/m-k	>9	ГОРЯЧИЙ ДИСК
	Максимальная рабочая температура	°C	< 700	
Химический состав	Карбид кремния	Чистота	>99%	
Различные сертификаты	Диэлектрическая прочность (DC)	Напряжение	6.96kV/mm	IEC 60243-2:2001 SGS
	Диэлектрическая прочность (AC)		4.87kV/mm	ASTM D149-09 Метод A / SGS
	RoHS		Уже прошло (Номер сертификата : GC130301375-GZ)	SGS
	Испытание на падение		Уже прошло (Номер сертификата: GZRL2012081591)	Падайте высоко 700mm на 30×30mm PCB / SGS

Вышеуказанное содержание и техническая информация основаны на экспериментальных результатах нашей компании, но они не используются в качестве юридического толкования или гарантии. Перед использованием пользователи должны оценить цель применения и область применения продукта.

SC-STG/DTG

Теплопроводящий гель

Введение

- Теплопроводящий гель серии SC-STG/DTG представляет собой пастообразный теплопроводящий материал для заполнения зазоров. Он формируется в соответствии с формой структуры; для неровной керамики, поверхности радиатора или нерегулярной полости он имеет наилучшую структурную применимость и соответствие поверхности структурных деталей, а зазор полностью заполнен
- Теплопроводящий гель серии SC-STG/DTG имеет хорошую изоляцию и сопротивление напряжению и термическую стабильность, а также безопасен и надежен в использовании
- Теплопроводящий гель серии SC-STG/DTG может течь под давлением как силиконовая смазка; он имеет высокую надежность под действием термического цикла и не затвердевает

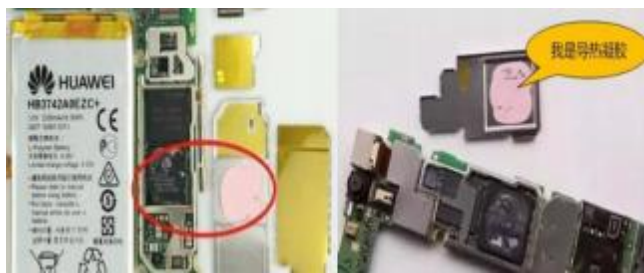
Свойство

- Однокомпонентное использование
- Нет отверждения, высокая надежность
- Хороший эффект нанесения в нерегулярных зазорах структуры
- Хорошая электроизоляция, отвечающая потребностям электронных устройств
- Хорошие механические свойства и устойчивость к атмосферным воздействиям



Приложение

- Коммуникационное оборудование
- Оборудование для хранения данных
- Мобильные телефоны, smart-часы
- Оборудование для обеспечения безопасности
- Сетевой терминал
- Светодиодные лампы
- Устройство электропитания



Характеристики однокомпонентного теплопроводящего геля (SC-STG)

Название продукта	SC-STG400	SC-STG600	SC-STG800
Цвет	Вермиллион	Желтый	Желтый
Теплопроводность (W/m ·K)	4.0±0.3	6.0±0.3	8.0±0.3
Плотность g/cm³	3.0	3.2	3.3
Объем экструзии (г/мин) Головка шприца 2,54 мм, давление 90 фунтов на кв. дюйм (банка 30 куб. см)	30±5	20±5	20±5
Прочность на разрыв (kV/mm)	>5	>5	>5
Объемное сопротивление (Ω ·cm)	9.5x 10 ¹³	4x 10 ¹³	4x 10 ¹³
Рабочая температура (F/°C)	-40~150	-40~150	-40~150
Способ доставки	Объем упаковки шприца (или банки) : 30cc /pc, 300cc /pc, 2600cc /pc		
Срок годности (@25±5°C, 70% RH)	6 месяцев		

Вышеуказанное содержание и техническая информация основаны на экспериментальных результатах нашей компании, но они не используются в качестве юридического толкования или гарантии. Перед использованием пользователи должны оценить цель применения и область применения продукта.

Спид Спреад Электронные Материалы Компания

SC-DTG

Теплопроводящий гель

Характеристики двухкомпонентного теплопроводящего геля (SC-DTG)				
	SC-DTG180		SC-DTG350	
Производительность предварительного смешивания	Группа А	Группа В	Группа А	Группа В
Цвет	White	Yellow	White	Yellow
Вязкость (мПа• s)	250*10³	250*10³	200*10³	200*10³
Плотность g/cm³	2.65	2.65	2.75	2.75
Соотношение смешивания	1:1		1:1	
Производительность после микширования				
Цвет	желтый		желтый	
Твёрдость (Shore OO)	60(1:1 после отверждения)		60(1:1 после отверждения)	
Теплопроводность (W/mK)	1.8		3.5	
Прочность на разрыв (KV/mm)	>5		>5	
Класс огнестойкости	UL94 V-0		UL94 V-0	
Рабочая температура (°C)	-40-150		-40-150	
Время полного отверждения				
25°C (Часы)	5		15	
100°C (Минуты)	15		40	

Вышеуказанное содержание и техническая информация основаны на экспериментальных результатах нашей компании, но они не используются в качестве юридического толкования или гарантии. Перед использованием пользователи должны оценить цель применения и область применения продукта.

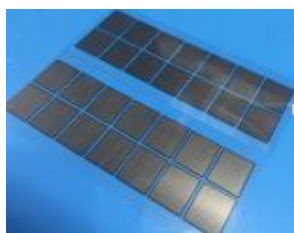
Точная высечка - резка



Профессиональная линия комбинированной высечки малых отверстий, продукция, отвечающая различным требованиям к перфорации



Машина для расстойки с ЧПУ, нет необходимости изготавливать формы, что экономит затраты клиентов на формы



Графитовая двухсторонняя высечка



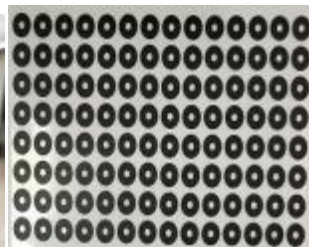
Высечка из пенопласта



Высечка медной и алюминиевой фольги



Высечка термопрокладок



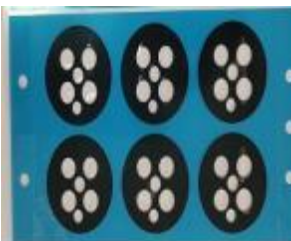
Высечка прокладок ПК



Высечка изоляционного материала



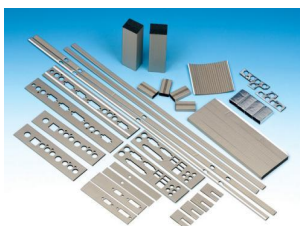
Двусторонняя клейкая высечка



Высечка клея для подложки камеры



Высечка защитной пленки



Проводящая пена

Вышеуказанное содержание и техническая информация основаны на экспериментальных результатах нашей компании, но они не используются в качестве юридического толкования или гарантии. Перед использованием пользователи должны оценить цель применения и область применения продукта.

Спид Спреад Электронные Материалы Компания



Ваш Успех – Наша Цель

Спасибо



С п и д С п р е а д

Э л е к т р о н н ы е

М а т е р и а л ы К о м п а н и я

с о г р а н и ч е н н о й

о т в е т с т в е н н о с т ь ю